

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep dan Teori.....	6
2.1.1 Kualitas	6

2.1.2 <i>Electrical Control Unit</i>	7
2.1.3 <i>Elektronik Part</i>	8
2.1.4 Alur Proses Pemasangan <i>Elektronik Part</i> di Mesin SMD	11
2.1.5 <i>Quality Assurance</i>	13
2.1.6 <i>Fault Tree Analysis</i>	15
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Subjek Dan Objek Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3 Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	26
3.3.1 <i>Quality Assurance</i>	26
3.3.2 <i>Fault Tree Analysis</i>	27
3.4 Langkah-Langkah Penelitian	28
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	
4.1 Data Kesalahan Pasang <i>Elektronik Part</i>	29
4.1.1 Kesalahan Pasang <i>Elektronik Part</i> Tahun 2014	29
4.1.2 Kesalahan Pasang <i>Elektronik Part</i> Tahun 2016	35

4.1.3 Kesalahan Pasang Elektronik <i>Part</i> Tahun 2018	37
4.2 Sistem <i>Scan</i> SMD	40
4.2.1 Motorola Scanner	40
4.2.2 Keyence Scanner.....	41

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyusunan <i>Fault Tree Analysis</i>	43
5.2 Analisa Perbaikan	46
5.3 Saran Perbaikan	48
5.3.1 Pembuatan Label Baru	48
5.3.1.1 Informasi Label Baru	48
5.3.1.2 Alur Proses dan Software Pembuatan Label Baru	49
5.3.1.3 Perlengkapan Pembuatan Label baru	53
5.3.2 Program Konfirmasi Elektronik <i>Part</i>	54

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
Daftar Pustaka.....	58